

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-274267

(43)Date of publication of application : 08.10.1999

(51)Int.Cl.

H01L 21/68

(21)Application number : 10-094006

(71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing : 23.03.1998

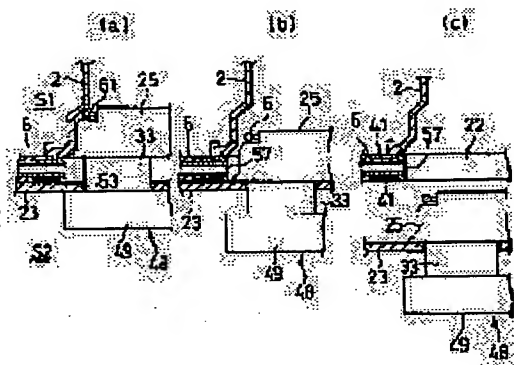
(72)Inventor : KIKUCHI HISASHI  
ISHII KATSUMI

## (54) METHOD AND DEVICE FOR TREATMENT

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To prevent air from entering a loading area from the open air working area, and to treat a substrate without increasing the concentration of oxygen in the loading area by air in a carrier.

**SOLUTION:** In a treatment method, a carrier 2 that accommodates a plurality of substrates W to be treated and is closed by a lid 25 is brought into contact with an opening part 22 of a partition wall 6 for partitioning an open air side from a loading area S2 side of inert gas atmosphere, a door 23 for closing the opening part 22 and a lid 25 of the carrier 2 are opened for opening the inside of the carrier 2 to the loading area S2 side, and the substrate W to be treated in the carrier 2 is carried to the loading area S2 side from the opening part 22 for treating. While the door 23 is closed, the lid 25 is opened, the inside of the carrier 2 is substituted for an inert gas, and the inside of the carrier 2 is opened to the loading area S2 side.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.05.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-274267

(43) 公開日 平成11年(1999)10月8日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

H 0 1 L 21/68

識別記号

F I

H 0 1 L 21/68

A

T

審査請求 未請求 請求項の数 3 F D (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平10-94006

(22) 出願日 平成10年(1998)3月23日

(71) 出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目3番6号

(72) 発明者 菊地 寿

岩手県江刺市岩谷堂字松長根52番地 東京  
エレクトロン東北株式会社東北事業所内

(72) 発明者 石井 勝美

神奈川県津久井郡城山町町屋1丁目2番41  
号 東京エレクトロン東北株式会社相模事  
業所内

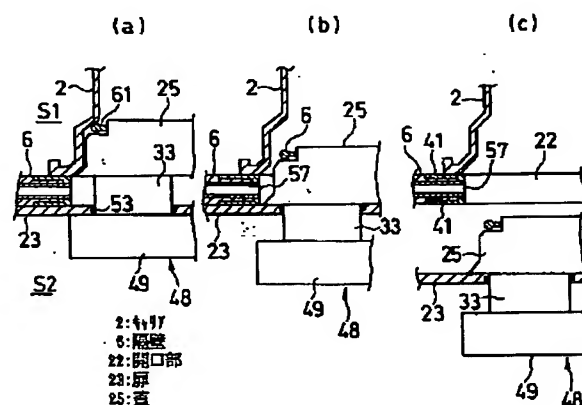
(74) 代理人 弁理士 金坂 憲幸

(54) 【発明の名称】 処理方法および処理装置

(57) 【要約】

【課題】 大気側の作業領域からローディングエリアへの大気の侵入を防ぎ、キャリア内の空気によってローディングエリアの酸素濃度を上げることなく被処理基板の処理を可能とする。

【解決手段】 大気側と不活性ガス雰囲気とのローディングエリアS2側を仕切る隔壁6の開口部22に、複数枚の被処理基板Wが収容されて蓋25で密閉されたキャリア2を大気側から当接させ、上記開口部22を閉鎖する扉23および上記キャリア2の蓋25を開けてキャリア2内をローディングエリアS2側に開放し、上記開口部22からキャリア2内の被処理基板WをローディングエリアS2側に搬送して処理する処理方法において、上記扉23を閉鎖した状態で上記蓋25を開けてキャリア2内を不活性ガスで置換した後、キャリア2内をローディングエリアS2側に開放する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 大気側と不活性ガス雰囲気とのローディングエリア側を仕切る隔壁の開口部に、複数枚の被処理基板が収容されて蓋で密閉されたキャリアを大気側から当接させ、上記開口部を閉鎖する扉および上記キャリアの蓋を開けてキャリア内をローディングエリア側に開放し、上記開口部からキャリア内の被処理基板をローディングエリア側に搬送して処理する処理方法において、上記扉を閉鎖した状態で上記蓋を開けてキャリア内を不活性ガスで置換した後、キャリア内をローディングエリア側に開放することを特徴とする処理方法。

【請求項2】 大気側と不活性ガス雰囲気とのローディングエリア側を仕切る隔壁の開口部に、複数枚の被処理基板が収容されて蓋で密閉されたキャリアを大気側から当接させ、上記開口部を閉鎖する扉および上記キャリアの蓋を開けてキャリア内をローディングエリア側に開放し、上記開口部からキャリア内の被処理基板をローディングエリア側に搬送して処理する処理装置において、上記扉を閉鎖した状態で上記蓋を開閉する蓋開閉機構と、上記扉を閉鎖した状態で蓋が開けられたキャリア内を不活性ガスで置換する不活性ガス置換手段とを具備することを特徴とする処理装置。

【請求項3】 上記不活性ガス置換手段が上記開口部の縁部に設けられた不活性ガス供給孔部および排気孔部からなることを特徴とする請求項2記載の処理装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、処理方法および処理装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 半導体装置の製造においては、被処理基板である半導体ウエハに例えば酸化、拡散、CVD等の各種の処理を施す工程があり、このような処理を行う装置として例えば熱処理装置が用いられている。この熱処理装置は、オペレータや自動搬送ロボットが複数枚の半導体ウエハを収容したキャリアを持ち運ぶ作業領域と、キャリア内の半導体ウエハを基板保持具であるウエハポートに移替えて熱処理炉への搬入搬出を行うローディングエリアとを備えている。

【0003】 このような熱処理装置においては、ローディングエリアを作業領域よりも清浄な雰囲気とすると共に半導体ウエハの自然酸化膜の発生等を防止するために、大気側の作業領域とローディングエリアを隔壁で仕切り、ローディングエリア内を不活性ガス例えば窒素( $N_2$ )で満たした不活性ガス雰囲気とすることが好ましい。また、上記熱処理装置には、半導体ウエハのパーティクル汚染を抑えるために、半導体ウエハの取出口が蓋で密閉されている密閉型のキャリア(クローズ型キャリアともいう)を適用することが更に好ましい。

【0004】 この場合、作業領域とローディングエリア

を仕切る隔壁にキャリアを作業領域側から当接させるための開口部を形成し、この開口部にはこれを閉鎖する扉を設ける。処理を行う場合には、上記開口部にキャリアをセットし、開口部の扉および上記キャリアの蓋を開けてキャリア内をローディングエリア側に開放し、開口部からキャリア内の半導体ウエハをローディングエリア側に搬送してウエハポートへの移替えを行い、このウエハポートを熱処理炉内に搬入して所定の熱処理を行うようにすればよい。なお、特開平8-279546号公報には、開口部の扉とキャリアの蓋と一緒に開放する技術が開示されている。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、上記キャリアは、内部を特別に不活性ガスで置換しない限り、通常は内部が大気すなわち空気で満たされた状態にある。このため、上記キャリアを開口部にセットして扉と共にキャリアの蓋を開けた場合に、キャリア内の空気がローディングエリア側に流出することが考えられる。キャリア内の空気がローディングエリア側に流出すると、ローディングエリア内の酸素濃度が高くなるため、不活性ガスの置換に時間がかかるだけでなく、半導体ウエハの自然酸化膜の発生等、プロセスへの影響も懸念される。

【0006】 そこで、本発明は、このような課題を解決するためになされたものである。本発明の目的は、大気側の作業領域からローディングエリアへの大気の侵入を防ぎ、またキャリア内の空気によってローディングエリアの酸素濃度を上げることなく被処理基板の処理ができる処理方法および処理装置を提供することにある。

## 【0007】

【課題を解決するための手段】 本発明のうち請求項1に係る発明は、大気側と不活性ガス雰囲気とのローディングエリア側を仕切る隔壁の開口部に、複数枚の被処理基板が収容されて蓋で密閉されたキャリアを大気側から当接させ、上記開口部を閉鎖する扉および上記キャリアの蓋を開けてキャリア内をローディングエリア側に開放し、上記開口部からキャリア内の被処理基板をローディングエリア側に搬送して処理する処理方法において、上記扉を閉鎖した状態で上記蓋を開けてキャリア内を不活性ガスで置換した後、キャリア内をローディングエリア側に開放することを特徴とする。

【0008】 請求項2に係る発明は、大気側と不活性ガス雰囲気とのローディングエリア側を仕切る隔壁の開口部に、複数枚の被処理基板が収容されて蓋で密閉されたキャリアを大気側から当接させ、上記開口部を閉鎖する扉および上記キャリアの蓋を開けてキャリア内をローディングエリア側に開放し、上記開口部からキャリア内の被処理基板をローディングエリア側に搬送して処理する処理装置において、上記扉を閉鎖した状態で上記蓋を開閉する蓋開閉機構と、上記扉を閉鎖した状態で蓋が開けられたキャリア内を不活性ガスで置換する不活性ガス置換

手段とを具備することを特徴とする。

【0009】請求項3に係る発明は、請求項2記載の処理装置において、上記不活性ガス置換手段が上記開口部の縁部に設けられた不活性ガス供給孔部および排気孔部からなることを特徴とする。

【0010】

【実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて詳述する。図1は本発明を縦型熱処理装置に適用した実施の形態を示す概略的縦断面図、図3は同縦型熱処理装置の概略的横断面図である。

【0011】これらの図において、1はクリーンルーム内に設置される縦型熱処理装置の外郭を形成する筐体である。この筐体1内は、キャリア2の搬入搬出、保管等を行うための作業領域S1と、キャリア2内に収容された被処理基板である半導体ウエハWのウエハポート4への移替え（移載）、熱処理炉5へのウエハポート4の搬入搬出等を行うためのローディングエリアS2とに隔壁（バルクヘッド）6により仕切られている。

【0012】上記筐体1の前面部には、オペレータあるいは搬送ロボットによりキャリア2を搬入搬出するための搬入出口7が設けられ、この搬入出口7には上下に開閉移動するドア8が設けられている。作業領域S1には、搬入出口7近傍にキャリア2を置くための置き台9が設けられ、この置き台9の上方および隔壁6側の上方には複数個のキャリア2を保管しておくための棚状の保管部10が設けられている。

【0013】上記隔壁6側には、キャリア2を載置するためのキャリア載置台であるステージ（キャリアステージ）11が図示例では上下に2段設けられている。作業領域S1には、上記置き台9、保管部10およびステージ11の間でキャリア2の搬送を行うためのキャリア搬送機構12が設けられている。このキャリア搬送機構12は、作業領域S1の一侧部に設けられた昇降機構13により昇降移動される昇降アーム14と、この昇降アーム14に設けられ、キャリア2の底部を支持して水平方向に搬送する搬送アーム15とから主に構成されている。

【0014】一方、ローディングエリアS2の奥部上方には、下端が炉口として開口された縦型の熱処理炉5が設けられ、この熱処理炉5の下方には、炉内へのウエハポート4の搬入搬出および炉口の開閉を行う蓋体16が図示しない昇降機構により昇降可能に設けられている。この蓋体16の上部には、多数枚の半導体ウエハWを上下方向に所定の間隔で多段に支持するウエハポート4が保温筒17を介して載置されている。熱処理炉5は、蓋体16を下降させてウエハポート4を搬出させた際に炉口を塞ぐための開閉可能なシャッターを備えている（図示省略）。

【0015】ローディングエリアS2の一侧には、半導体ウエハWの移替え等のためにウエハポート4を載置し

ておくためのポート載置部18が図示例では二つ設けられている。また、ローディングエリアS2には、キャリア2とポート載置部18のウエハポート4の間で半導体ウエハWの移替えを行う移載機構19がアーム20を介して図3に実線で示す待機位置から仮想線で示す作業位置に移動可能に設けられていると共に、蓋体16とポート載置部18の間でウエハポート4の搬送を行うためのポート搬送機構21が設けられている。

【0016】上記作業領域S1は、図示しないフィルタを介して清浄な空気が供給されていて大気雰囲気とされている。上記ローディングエリアS2は、不活性ガス例えば窒素（ $N_2$ ）ガスが供給されていて不活性ガス雰囲気とされている。作業領域S1とローディングエリアS2を仕切る隔壁6には、上記キャリア2を大気側である作業領域S1側から当接するための開口部22が図示例では上下に二つ形成されていると共に、各開口部22をローディングエリアS2側から閉鎖する扉23が開閉可能に設けられている。上記開口部22は、キャリア2のウエハ取出口24とほぼ同口径に形成されており、開口部22からキャリア2内の半導体ウエハWの出し入れが可能になっている。

【0017】上記キャリア2は、いわゆるクローズ型キャリアであり、複数枚の半導体ウエハWを収容すると共に蓋25で密閉されている。キャリア2は、図5に示すように、所定口径例えば直径30mmの半導体ウエハWを水平状態で上下方向に所定間隔で多段に複数枚例えば13枚もしくは25枚程度収容可能で持ち運び可能な容器からなり、その前面部に開口形成されたウエハ取出口24にこれを気密に塞ぐための蓋25を着脱可能に備えている。キャリア2および蓋25は、例えば合成樹脂により形成されており、キャリア2のウエハ取出口24周縁部には、フランジ部26が形成されている。

【0018】上記キャリア2の蓋25には、後述するキー操作機構27のキー28を挿入して回すことにより、蓋25の上端と下端から図示しないロックピンが突出または没入し、キャリア2のウエハ取出口24上縁および下縁の図示しない凹部に係合または離脱して蓋25を閉位置にロックまたは解除するための鍵穴29が例えば2箇所設けられている。蓋25は、通常、キャリア2に固定されたロック状態にあり、キー操作機構27のキー28を鍵穴29に挿入して回すと、ロックが解除されて蓋25がキー28側に保持されるように構成されている。

【0019】上記キー操作機構27は、駆動手段であるエアシリンダ30により左右方向にスライド操作される操作部材31と、この操作部材31により回動操作される回動部材32と、この回動部材32の回動軸33の先端部に設けられたキー28とから主に構成されている。上記操作部材31と回動部材32は、操作部材31の直線運動を回動部材の回転運動に換えるために、リンク34を介して連結されているが、歯車機構を介して連結さ

れていてもよい。なお、蓋25の鍵穴29にキー28を挿入して回すと、図示しないロックピンが引っ込められてロックが解除され、蓋25がキー28に保持された状態になるようになっている。

【0020】上記隔壁6は、具体的にはその一部がキャリア2の前部側を収容する凹部35を形成すべく横断面溝状に形成されている。この凹部35の底面に相当する部分が内側にキャリア2を、外側に扉23をそれぞれ当接させるための当接壁36として形成されており、この当接壁36に開口部22が形成されている。上記凹部35には、キャリア2を載置するためのステージ11が図示例では上下に2段配設されている。このステージ11は、キャリア搬送機構12の搬送アーム15との干渉を避けるために、図6にも示すように、作業領域S1側に開放された平面U字状に形成されており、その上面部にはキャリア2の底部に形成された図示しない孔部に係合される位置決め用のピン38が突設されていると共に、キャリア2の有無を検知するキャリアセンサ39が設けられている。

【0021】上記凹部35の両側には、キャリア2のフランジ部26後面を押圧してキャリア2の前面部を隔壁6の開口部22周縁部に当接させて固定（ロック）するためのキャリア固定手段としてのキャリア固定用エアシリンダ40が配設されている。なお、上記ステージ11は、キャリア固定用エアシリンダ40により押圧移動されるキャリア2に追従し得るように前後方向に移動可能に支持されている。上記開口部22の周縁部には、当接されるキャリア2との間および扉23との間を気密にシールするためのシール部材41が設けられている（図7参照）。

【0022】上記扉23は、扉開閉機構37によってローディングエリアS2側に移動して開き、更に上下方向に移動して退避するようになっている。二つのステージ11のうち、いずれか一方のステージ11のキャリア2のみ半導体ウエハWへのアクセスが可能とされ、他方のステージ11の扉23は閉鎖されている。具体的には図2に示すように、上部のステージ11の扉23が閉鎖されている時、下部のステージ11の扉23が開放されて上方に退避され、下部のステージ11の扉23が閉鎖されている時、上部のステージ11の扉23が開放されて下方に退避されるように構成されている。

【0023】上記扉23は、図4に示すように、隔壁6の凹部35両外側部に対応するように延出された支持腕部42を有している。この扉23を上述のように開閉操作する扉開閉機構37は、隔壁6の凹部35両外側部に上下動ガイド43を介して上下移動可能に支持された上下可動枠44を有し、この上下可動枠44には前後動ガイド45を介して上記扉23の支持腕部42が前後移動可能に支持されている。上記上下可動枠44には、これを上下に駆動（昇降）するための扉昇降用エアシリンダ4

6が連結されている共に、支持腕部42を介して扉23を前後方向に開閉移動するための扉開閉用エアシリンダ47が取付けられている。図4の図示例では、一方（右側）の扉昇降用エアシリンダ47が上部の扉23を、他方（左側）の扉昇降用エアシリンダ47が下部の扉23をそれぞれ上下に駆動するようになっている。

【0024】扉23が閉鎖した状態でキャリア2の蓋25の開閉を行うために、上記扉23には、扉23とは独立してキャリア2の蓋25の開閉を行うための蓋開閉機構48が設けられている。隔壁6は、蓋開閉機構48によりキャリア2の前面部から前方に移動されて開状態とされた蓋25を開口部22内に収容し得るスペースを確保する厚さに形成されている。上記蓋開閉機構48は、扉23の前面部に前後移動可能に配置された前後移動枠49を有し、この前後移動枠49に上記キー操作機構27が組込まれている。図示例の前後移動枠49は、扉23の両支持腕部42に対応するように延出された支持腕部50を有しており、この両支持腕部50が扉23の両支持腕部42に蓋開閉用のガイド付エアシリンダ51を介して前後移動可能に支持されている。

【0025】蓋開閉機構48の前後移動枠49に組込まれたキー操作機構27の回転軸33は、図7に示すように、扉23に対して前後方向に摺動可能および回転可能に貫通している。扉23には、上記回転軸33が貫通する貫通孔52が形成されており、この貫通孔52には、図9に示すように、回転軸貫通部の軸封手段として、Oリング等のシール部材53が設けられている。また、扉23には、上記回転軸貫通部から作業領域S1側の大気（空気）がローディングエリアS2側に漏れないようすると共にキー28周辺部のパーティクル対策として、回転軸貫通部およびキー28周辺部を図示しない減圧ポンプにより減圧排気するための排気溝54および排気孔55が設けられている。

【0026】上記扉23を閉鎖した状態で上記蓋開閉機構48により蓋25が開けられたキャリア2内を不活性ガスで置換するために、上記開口部22には不活性ガス置換手段56が設けられている。この不活性ガス置換手段56は、図8に示すように、開口部22の縁部に設けられた不活性ガス供給孔部57および排気孔部58からなっている。不活性ガスとしては、例えば窒素（ $N_2$ ）ガスが用いられる。キャリア2内および開口部22内を不活性ガスで円滑に置換するために、開口部22の左右対向縁部の一侧に不活性ガス供給孔部57を、他側に排気孔部58をそれぞれ適宜間隔で設け、不活性ガスをキャリア2内の半導体ウエハWの面と平行に流すように構成することが好ましい。

【0027】上記不活性ガス供給孔部57は不活性ガス供給管58を介して不活性ガス供給源に接続され、排気孔部58は排気管60を介して排気系に接続されている。上記排気管60には、図示しない酸素濃度センサが

設けられており、酸素濃度が所定値まで下がった時に、不活性ガス置換作業を終了し、扉23を開放、退避するように構成されている。蓋25は、扉23と共に開放、退避される。蓋25の開閉、不活性ガスの置換、扉23の開閉等は、予め設定されたプログラムに基づいて図示しない制御装置により制御されるように構成されている。なお、図7において、61はキャリア2と蓋25の間にシールするシール部材である。

【0028】次に、作用ないし処理方法を述べる。先ず、キャリア搬送機構12によりキャリア2をステージ11上に搬送して載置する。キャリア2がステージ11上に載置されたことがキャリアセンサ39により検知されると、キャリア固定エアシリンダ40の駆動によりキャリア2が隔壁6の開口部22に押圧されて気密状態に当接固定される。この時、開口部22は扉23により予め閉鎖されており、キー28は隔壁6から突出しているとキャリア2と干渉するため予め開口部22内に引き込まれている。

【0029】次に、図7(a)に示すように、扉23が閉鎖および蓋25が密閉されている状態で不活性ガス置換を行い、扉23と蓋25の間の大気を取り除いて不活性ガスを充填させる。その後で、上記扉23の閉鎖状態で上記キャリア2の蓋25を開け、キャリア2内を不活性ガス置換手段56により不活性ガスで置換する。この場合、蓋開閉機構48の作動により、図7(a)に示すように、前後移動棒19を介してキー28をキャリア2の蓋25側へ前進させ、キー28を蓋25の鍵穴29に挿入して回すことによりロックを解除する。この解除状態で、図7(b)に示すように、キー28を後退させて蓋25を扉23に当接するまで開口部22内に引き込むことにより開ける。

【0030】この状態で、不活性ガス置換手段56の不活性ガス供給孔部57から不活性ガス例えば窒素( $N_2$ )ガスを供給すると共に、排気孔部58から排気することにより、キャリア2内を不活性ガスで置換する。不活性ガスは、一側の不活性ガス供給孔部57からキャリア2と蓋25の隙間を通してキャリア2内に入り、他側の排気孔部58より排気されることにより、キャリア2内および開口部22内に残存する空気を追い出してキャリア2内および開口部22内を不活性ガスで満たす。不活性ガスの供給を開始するタイミングは、キャリア2を開口部22に当接固定した時点からキャリア2の蓋25を開けた時点の間であれば何れでもよい。

【0031】キャリア2内が不活性ガスで置換されたかどうかは、酸素濃度センサにより検知される。キャリア2内が不活性ガスで置換されると、不活性ガスの供給を停止し、図7(c)に示すように、扉23と共に蓋25を開放して上下方向に退避させ、キャリア2内をローディングエリアS2側に開放する。次いで、キャリア2内の半導体ウエハWを移載機構19によりウエハポート

4に移載し、キャリア2内の半導体ウエハWが空になったら、扉23および蓋25を閉め、ステージ11上の空のキャリア2を保管部10のキャリア2と交換し、ウエハポート4に半導体ウエハWが所定枚数例えば100～150枚程度移載されるまで上記作業を繰り返す。そして、上記ウエハポート4を熱処理炉5内に搬入して半導体ウエハWに所定の熱処理を施せばよい。熱処理が終了したなら、ウエハポート4を熱処理炉5から搬出し、上記とは逆の手順でウエハポート4から空のキャリア2内に処理済みの半導体ウエハWを移載すればよい。

【0032】このように大気側と不活性ガス雰囲気とのローディングエリアS2側を仕切る隔壁6の開口部22に蓋25で密閉されたキャリア2を大気側から当接させたなら、上記開口部22を閉鎖する扉23および上記キャリア2の蓋25を同時に開けるのではなく、先ず上記扉23を閉鎖したままの状態上記蓋25のみを開けてキャリア2内を不活性ガスで置換してから、扉23および蓋25を開けてキャリア2内をローディングエリアS2側に開放するようにしたので、大気側の作業領域S1からローディングエリアS2への大気の侵入を防ぎ、またキャリア2内の空気がローディングエリアS2側に流出するのを未然に防止することができる。従って、ローディングエリアS2の不活性ガスの置換に時間がかからないばかりか、半導体ウエハWの自然酸化膜の発生等、プロセスへの影響もない。すなわち、キャリア2内の空気によってローディングエリアS2の酸素濃度を上げることなく半導体ウエハWの処理を行うことができ、スルーバットおよび歩留りの向上が図れる。

【0033】以上、本発明の実施の形態を図面により詳述してきたが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種々の設計変更等が可能である。例えば、キャリア固定手段としては、図10に示すようなキャリアロック機構64を採用してもよい。このキャリアロック機構64は、隔壁6の開口部22の近傍に支軸65を介して回転可能に軸支されたロックアーム66を有し、このロックアーム66を回転させてキャリア2のフランジ部26に当接させ、これを押圧固定するように構成されている。また、蓋開閉機構48としては、図11に示すように、支持腕部50を有しない前後移動棒49を用い、この前後移動棒49を扉23の前面部にエアシリンダ67を介して前後移動可能に設けた構成としてもよく、これにより構造の簡素化および省スペース化が図れる。

【0034】

【発明の効果】以上要するに本発明によれば、次のような効果を奏することができる。

【0035】(1)請求項1記載の処理方法によれば、大気側と不活性ガス雰囲気とのローディングエリア側を仕切る隔壁の開口部に蓋で密閉されたキャリアを大気側から当接させたなら、上記開口部を閉鎖する扉および上記

キャリアの蓋を同時に開けるのではなく、先ず上記扉を閉鎖したままの状態を上記蓋のみを開けてキャリア内を不活性ガスで置換してから、扉および蓋を開けてキャリア内をローディングエリア側に開放するようにしたので、大気側の作業領域からローディングエリアへの大気の侵入を防ぎ、またキャリア内の空気がローディングエリア側に流出するのを未然に防止することができ、キャリア内の空気によってローディングエリアの酸素濃度を上げることなく被処理基板の処理を行うことが可能となる。

【0036】(2)請求項2記載の処理装置によれば、大気側と不活性ガス雰囲気とのローディングエリア側を仕切る隔壁の開口部に蓋で密閉されたキャリアを大気側から当接させたなら、上記開口部を閉鎖する扉および上記キャリアの蓋を同時に開けるのではなく、先ず上記扉とは独立した蓋開閉機構により扉を閉鎖したままの状態で蓋のみを開け、キャリア内を不活性ガス置換手段により不活性ガスで置換してから、扉および蓋を開けてキャリア内をローディングエリア側に開放するようにしたので、簡単な構成で大気側の作業領域S1からローディングエリアS2への大気の侵入を防ぎ、またキャリア内の空気がローディングエリア側に流出するのを確実に防止することができ、キャリア内の空気によってローディングエリアの酸素濃度を上げることなく被処理基板の処理を行うことが可能となる。

【0037】(3)請求項3記載の処理装置によれば、上記不活性ガス置換手段が上記開口部の縁部に設けられた不活性ガス供給孔部および排気孔部からなるため、簡単な構成で開口部およびキャリア内を容易に不活性ガスで置換することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を縦型熱処理装置に適用した実施の形態を示す概略的縦断面図である。

【図2】同縦型熱処理装置内の隔壁の開口部を閉鎖する扉の開放退避方法を説明する説明図である。

【図3】同縦型熱処理装置の概略的横断面図である。

【図4】扉および蓋の開閉機構を示す斜視図である。

【図5】キャリアおよびキー操作機構を示す斜視図である。

【図6】キャリアステージの近傍に配設された各種の機構を示す斜視図である。

【図7】蓋および扉の開閉方法を説明する説明図である。

【図8】不活性ガス置換手段の構成を示す概略的正面図である。

【図9】扉を貫通した回転軸の軸封手段の一例を示す部分的拡大断面図である。

【図10】キャリアを隔壁の開口部に固定する機構の他の例を示す図である。

【図11】蓋開閉機構の他の例を示す図である。

【符号の説明】

W 半導体ウエハ(被処理基板)

2 キャリア

6 隔壁

S2 ローディングエリア

22 開口部

23 扉

25 蓋

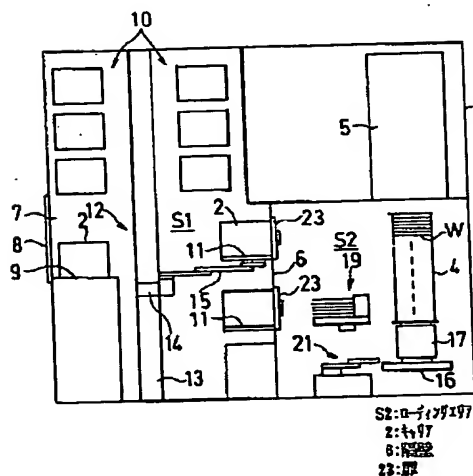
48 蓋開閉機構

56 不活性ガス置換手段

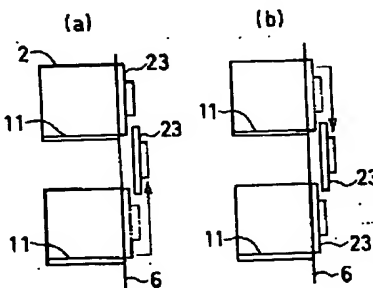
57 不活性ガス供給孔部

58 排気孔部

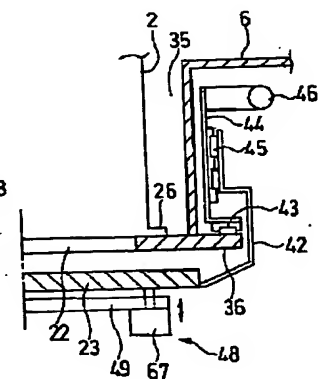
【図1】



【図2】

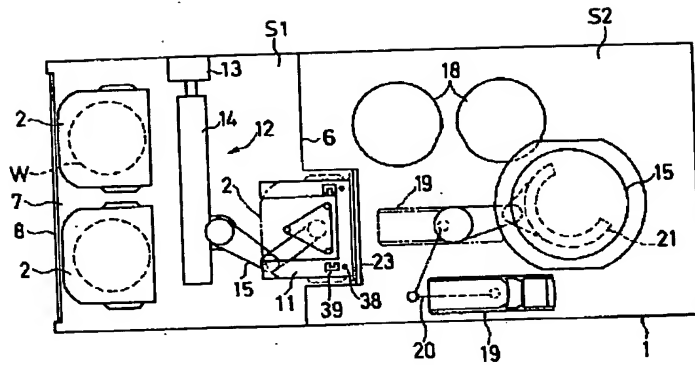


【図11】

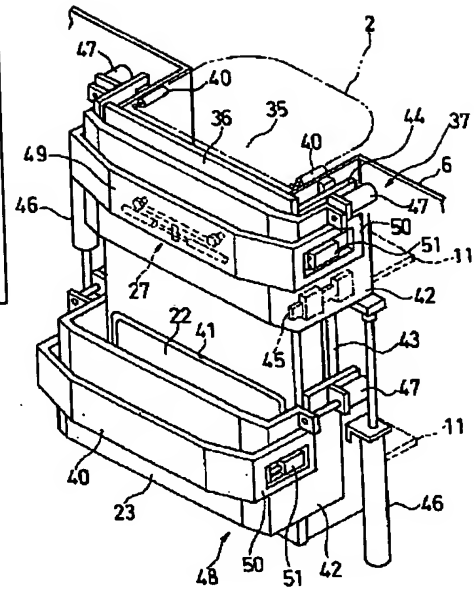




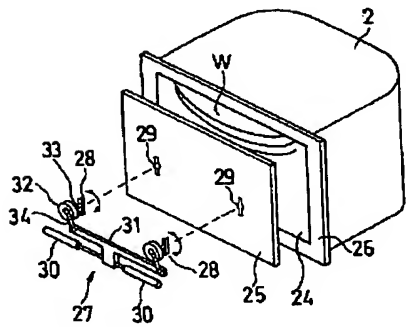
【図3】



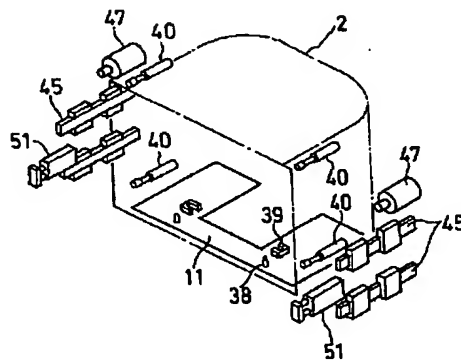
【図4】



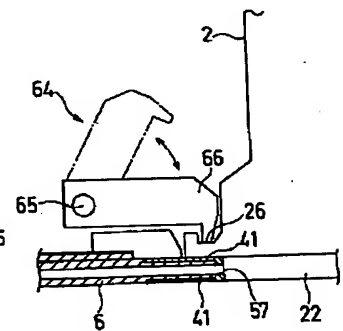
【図5】



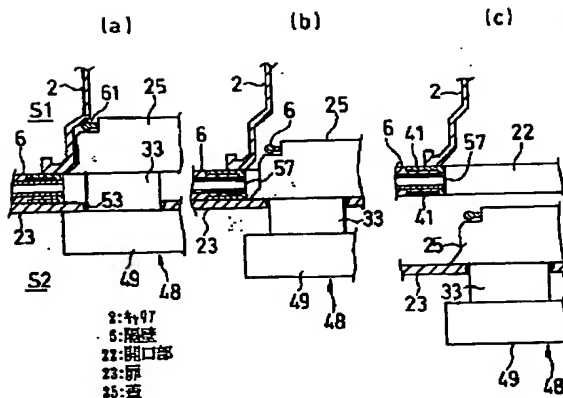
【図6】



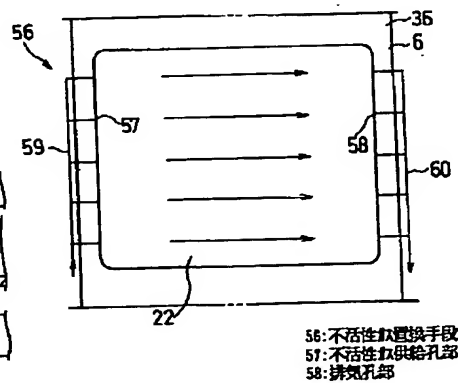
【図10】



【図7】



【図8】



2:外殻  
5:隔壁  
23:開口部  
25:蓋

56:不活性氣體換手段  
57:不活性氣體供給部  
58:排氣孔部



(8)

特開平11-274267

【図9】

